**证券代码：688521 证券简称：芯原股份**

**芯原微电子（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √ 特定对象调研 □ 分析师会议  □ 媒体采访 □ 业绩说明会  □ 新闻发布会 √ 路演活动  □ 现场参观 □ 电话会议  □ 其他（ ） |
| **参与单位名称** | 2024年5月21日  Coreview Capital、Point72、Neuberger Berman Asia Ltd、Polunin Capital Partners、Pictet Asset Management等  2024年5月22日  Balyasny Asset Management、HSBC Global Asset Management、Infini Capital、Quad Investment Management、Yiheng Capital等  2024年5月23日  Vontobel Asset Management、China Alpha Fund Management、中国诚通基金、Dymon Asia Capital  2024年5月24日  南方东英资产管理、Barings Asset Management、Athos Capital |
| **时间** | 2024年5月21日、5月22日、5月23日、5月24日 |
| **调研方式** | 线下会议 |
| **公司接待人员姓名** | 公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）  公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | |
| **公司介绍** | 芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP共六类处理器IP、1,500多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司等。  芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现5nm系统芯片（SoC）一次流片成功，多个5nm一站式服务项目正在执行。根据IPnest在2024年的统计，从半导体IP销售收入角度来看，芯原是中国排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，芯原的IP种类排名前二。 |
| **交流问答** | **问题：公司一季度在汽车电子领域收入增速较快，请问具体是哪些客户需求带动？**  回复：在2024年第一季度，公司汽车电子领域收入同比增长162.46%，占整体营业收入22.41%，较2023年增加15.7个百分点。近年来，汽车行业的机遇持续提升，为应对该领域不断增长的市场需求，我们为整个智能像素处理IP组合都部署了汽车功能安全认证计划，目前，芯原的IP已授权给了全球20多家汽车电子客户；此外，芯原推出了功能安全（FuSa）SoC平台的总体设计流程，以及基于该平台的高级驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架，正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作，例如，我们正在为国内知名的新能源汽车客户定制符合车规功能安全认证、对标国际先进汽车芯片技术的5nm高性能智驾系统级芯片。  **问题：请问公司的研发人员主要分布在哪些地区？**  回复：芯原专注于面向全球集成电路产业科技前沿的芯片定制技术和半导体IP技术进行持续研发，高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。截至2023年末，公司拥有研发人员1662人，占员工总人数的89.16%；公司约97%的研发人员在国内，主要分布在上海、成都、南京等地。  **问题：AI PC、AI手机等应用需求增长，请问公司在相关领域有哪些技术布局？**  回复：随着边缘人工智能应用快速发展，公司不断优化升级相关IP技术，提升公司自身的竞争力和市场地位。目前，集成了芯原神经网络处理器（NPU）IP的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗，主要应用于包含智能手机、平板电脑、可穿戴设备等在内的10多个市场领域。为应对手机、电脑对AI算力持续增长的需求，公司一直以来持续优化和升级公司的NPU IP，并推出了一系列创新的AI-ISP、AI-GPU等基于公司NPU技术的IP子系统，给传统的处理器技术带来颠覆性的性能提升，为各类终端电子产品提供多维度、高效率的人工智能升级。公司始终关注市场趋势和技术发展动向，积极推进新技术的研发，基于自身半导体IP、芯片定制硬件、软件平台的技术赋能能力，持续提升公司在相关领域中的地位与价值。  **问题：请问公司芯片设计的流片成功率如何？**  回复：公司的流片成功率比较高，大部分芯片设计项目都能做到一次流片成功，这得益于公司优秀的芯片设计能力和丰富的芯片设计经验。通过多年来的技术积累，公司拥有先进的从硬件到软件的一站式芯片定制技术，以及丰富的半导体IP储备，能够帮助客户高效率、高质量、低成本、低风险地完成芯片的设计实现和量产出货。    **问题：请问公司目在Chiplet技术上的研发进展如何？**  回复：作为全球领先的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务供应商，Chiplet技术迭代研发及产业化落地是芯原发展的核心战略之一。芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业之一，公司正在以“IP芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口IP、Chiplet芯片架构、先进封装技术、面向AIGC和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司Chiplet技术、项目的发展和产业化。  目前，芯原已帮助客户设计了基于Chiplet架构的高端多媒体应用处理器芯片，采用了MCM先进封装技术，将高性能SoC和多颗IPM内存合封；已帮助客户的高算力AIGC芯片设计了2.5DCoWoS封装；已设计研发了针对Die to Die连接的UCIe/BoW兼容的物理层接口；已和Chiplet芯片解决方案的行业领导者蓝洋智能合作，为其提供包括GPGPU、NPU和VPU在内的多款芯原自有处理器IP，帮助其部署基于Chiplet架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。  目前，芯原正在持续推进关键功能模块Chiplet、Die to Die接口、Chiplet芯片架构、先进封装技术的研发工作。同时，芯原还将进一步迭代并推广采用Chiplet架构所设计的高端应用处理器平台。此外，公司还基于自有的通用图形处理器（GPGPU）IP、NPUIP、UCIe物理层（PHY）等技术，正在积极推进面向AIGC和汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）应用、采用Chiplet架构的芯片设计平台的研发。  **问题：请问公司未来IP技术的研发是如何规划的？**  回复：通过多年的研发积累，公司拥有自主的六大处理器IP、1500多个数模混合IP和射频IP，IP齐备程度很高，各IP的市场竞争力也非常强。根据IPnest在2024年的统计，从半导体IP销售收入角度，芯原是中国排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商；在全球排名前七的企业中，IP种类排名前二。  随着市场和行业的发展，我们原有的IP会持续根据客户和市场需求迭代，在此基础上，我们也会根据技术和市场发展趋势，结合公司自身的优势，有计划地丰富公司的IP版图，多个IP行成“组合拳”来更好地满足不同场景下的客户需求。  目前，我们已推出了基于半导体IP的平台授权业务模式，这种授权平台通常含有公司的多个IP产品，IP之间有机结合形成了子系统解决方案和平台解决方案，优化了IP之间协处理的效率、降低了系统功耗，简化了系统设计。此外，各个自有IP还可以有机结合，实现技术创新，例如芯原的NPU IP可以结合芯原其他处理器IP，支持多种应用场景的人工智能升级发展，目前，我们的AI-ISP系列已经广泛获得了手机、机器视觉相关应用客户的青睐。类似的AI-Video技术、AI和GPGPU的结合等等，都在相关行业龙头客户的产品中发挥显著作用。  **问题：公司坚持晶圆厂中立，请问和各家晶圆厂的关系如何，是否可以满足客户的芯片设计需求？**  回复：公司坚持晶圆厂中立原则，与全球各大晶圆厂有超过10 年或 15 年的长期合作关系，通过多年的良好沟通，与各大晶圆厂保持了紧密联系并长期合作。在为客户提供一站式芯片定制服务时，公司可以根据客户的产品需求情况，为客户遴选合适的晶圆厂来完成芯片制造。在2021年，行业产能紧张的情况下，得益于公司的产业链资源优势，公司量产业务同比增长 35.40%。 |